

DESIGN STUDY OF A LOW EMITTANCE INJECTOR SYNCHROTRON WITH MULTI-BEND ACHROMAT LATTICES FOR AN ULTRA-LOW EMITTANCE STORAGE RING

Koji Tsumaki

JASRI/SPring-8

1-1-1 Kouto, Sayo, Hyogo, 679-5198

Abstract

Since dynamic aperture of an ultra-low emittance storage ring is generally very small, a low emittance injector synchrotron is required to maintain the high injection efficiency. Most of the synchrotrons consist of FODO cell lattice for its simple lattice structure. But the theoretical minimum emittance (TME) lattice can reach lower emittance than FODO cell lattice considering a single cell. Thus we studied a synchrotron consisting of multi-bend achromat lattice that is close to the TME lattice. We applied the multi-bend achromat lattice to the SPring-8 synchrotron. Two synchrotrons with different cell length were designed. The emittance reaches to 1.9 nm for a shorter cell length synchrotron with +6.0mm/-6.6 mm dynamic aperture. Achieved emittance is 1/120 of the present SPring-8 synchrotron.

超低エミッタス蓄積リングのための入射用 低エミッタスシンクロトロンの設計研究

1. はじめに

現在世界各地で次世代の超低エミッタス蓄積リングの検討がなされている^[1]。一般的にエミッタスが小さくなればなるほど、ダイナミックアーチャが小さくなるため、エミッタスの小さな次世代蓄積リングで高い入射効率を保つためには、エミッタスの小さな入射ビームが必要不可欠となる。入射器としてシンクロトロンを考えた場合、エミッタスの大きな現在のシンクロトロンではこの要求を満足させることは非常に難しい。そのため、現在の第3世代の蓄積リング程度のエミッタスを持つ、低エミッタスシンクロトロンが必要となる。

以前、SPring-8シンクロトロンをFODOセルラティスにより低エミッタス化する可能性について検討し、その結果について報告した^[2]。一方エミッタスを最小にできるのは、Theoretical Minimum Emittance(TME)ラティスであるが、FODOではTMEにすることができない。そこで今回、SPring-8シンクロトロンをTMEラティスに近い(MEラティス)Multi-Bend-Achromat(MBA)ラティスで設計し、極限までエミッタス低減を追求したので、その結果について報告する。

2. エミッタス

電子蓄積リングのエミッタスは、式(1)のように表される。

$$\varepsilon = F \frac{C_q \gamma^2 \theta^3}{J_x} \quad (1)$$

表1 : SPring-8シンクロトロンの主なパラメータ^[3]

エネルギー(最大)	8 GeV
周長	396.12 m
チューン v_x/v_y	11.73/8.78
FODOセルの長さ	9.903 m
エミッタス	230 nm
偏向電磁石数	64
長さ	2.9 m
強さ	0.90338 T

ここで、 $C_q = 3.83 \times 10^{-13}$ m、 $\gamma = 1/(1-\beta^2)^{1/2}$ 、 θ は偏向電磁石の偏向角、 J_x はダンピングパーティション数、 F はラティスによって決まるパラメータである。エネルギーが決まっていて、 J_x もいじらないとするとエミッタスを小さくするには、 F を小さくして、 θ を小さくすれば良い。ここではラティスをTMEに近いMBAにして F を小さくし、単位セルの長さを短くして偏向電磁石の数を増やし θ を小さくすることにより、エミッタスを下げるものとする。

上記の方針のもと、シンクロトロンを設計した。表1に現在のシンクロトロンの主なパラメータを示す。偏向電磁石の数を増やすために、FODOラティスのときと同じように^[2]現在のシンクロトロンをもとに、単位セルの長さをFODOセルの1/2、1/2.5、1/3とした。この時、偏向電磁石の数はそれぞれ、66、

8.2、9.8となる。それぞれの場合について、MBAラティスのエミッターンスが、単位セルの位相とともにどのように変化し、どの程度のエミッターンスが得られるか計算した。図1に結果を示す。ただし偏向電磁石の強さはセル長が半分のとき1T、1/2.5のとき1.3T、1/3のとき1.5Tを仮定した。計算結果よりセル長を1/2にすると3.4 nm、1/2.5で1.7 nm、1/3にすると0.96 nmまで小さくなる可能性があることがわかる。

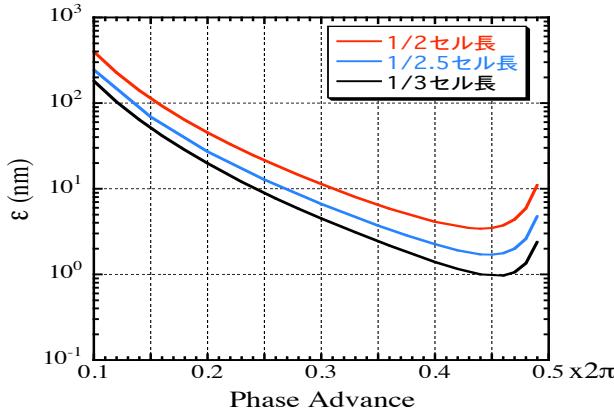


図1：単位セルあたりの位相の進みとエミッターンスの関係

3. ラティス設計

3.1 単位セルのエミッターンスと六極電磁石強度

セル長を短くして偏向電磁石の数を増やし、四極電磁石の収束力を増すことによりエミッターンスを小さくするが、それに伴いクロマティシティが大きく、ディスページョン関数が小さくなる。そのため六極電磁石の強度が強まり、ダイナミックアパーチャが小さくなるとともに、長さの長い磁石が必要になり現実的なスペースが得にくくなる。そこで、セル長をパラメータとして、得られるエミッターンスとそのときの六極電磁石の強さを求めた。結果を図2示す。これよりセル長を短くして、エミッターンスを小さくすると六極電磁石の強さが急速に強くなることがわかる。例えば1/2セル長の最小エミッターンス3.4 nmを1/3セル長のラティスで得ようとした場合、六極電磁石の強さは約3倍になる。また1/3セル長で最小エミッターンスを求める場合、六極電磁石の強さは約5倍となり強くなりすぎる。そこで1/3セル長のラティスはあきらめ、1/2セル長と1/2.5セル長の2ケースについて検討することにした。

3.2 電磁石強度

ラティスを設計するためには、磁石の長さを決めなければならない。長さを短くするためにボア径を40 mmとし、四極電磁石の最大磁場勾配を50 T/m、六極電磁石の最大磁場勾配を3000 T/m²として磁石長を決定した^[4]。

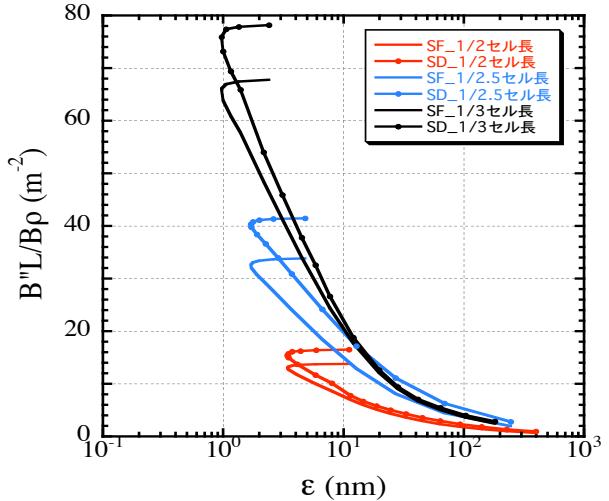


図2：エミッターンスと六極電磁石の関係

3.3 1/2セル長

単位セルのフェーズの進みが $0.44 \times 2\pi$ のとき最小エミッターンスとなるが、多少位相の進みを小さくしてもエミッターンスはあまり変わらないため、少しでも六極電磁石を弱くするため $0.42 \times 2\pi$ 近辺を設計ポイントとした。このとき最小エミッターンスからのエミッターンスの増加は0.2 nmで、ほとんど無視できる。また単位セル以外の長直線セルの位相の進みは 4π にとり、この部分には六極電磁石を置かないで、非線形ラティスの対称性を保つようにした。表2に主なパラメータを、図3にベータトロン関数とディスページョン関数を示す。このラティスに対して、3種類の六極電磁石を用いて、色収差を補正すると同時にダイナミックアパーチャを改善した。改善前と改善後のダイナミックアパーチャを図4に示す。最終的なエミッターンスは3.7 nmとなった。

表2：1/2セル長ラティスの主なパラメータ

エネルギー（最大）	6 GeV
周長	396.12 m
形状	レーストラック
チューン v_x/v_y	30.16/4.10
エミッターンス	3.7 nm
クロマティシティ ξ_x/ξ_y	78.7/73.4
偏向電磁石 数	66
長さ	1.9 m
強さ	1 T

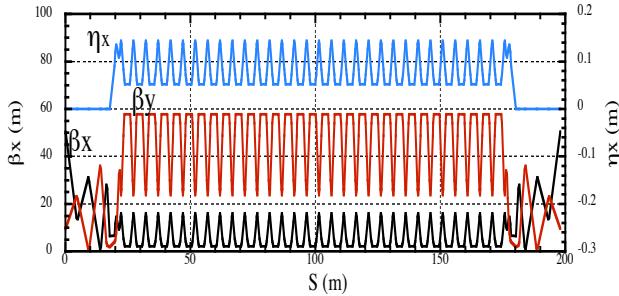


図3：1/2セル長のベータトロン関数とディスパージョン関数

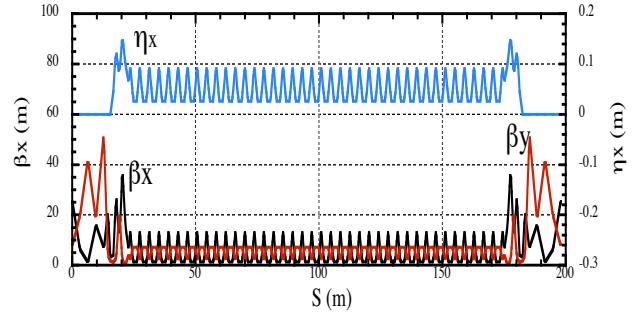


図5：1/2.5セル長のベータトロン関数とディスパージョン関数

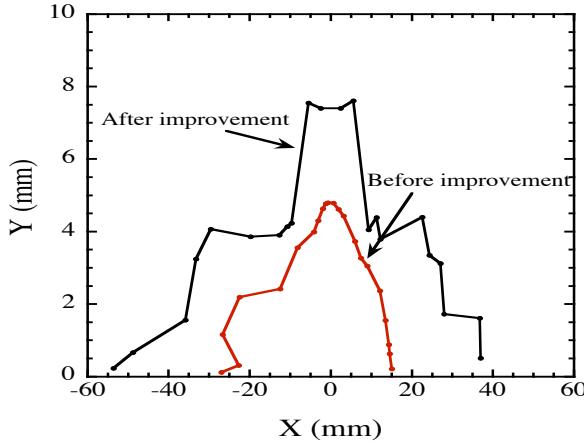


図4：1/2セル長のときのダイナミックアーチャ

3.4 1/2.5セル長

単位セルの位相の進みが $0.45 \times 2\pi$ の時、最小エミッタス1.7 nmとなるが、 $0.42 \times 2\pi$ でも1.9 nmのエミッタスが得られる。1/2セル長の場合と同じように六極電磁石の強さが少しでも弱くなるように、位相の進みは $0.42 \times 2\pi$ とした。また直線部の位相の進みも1/2セル長の時と同様に 4π とした。表3に1/2.5セル長ラティスの主なパラメータを、図5にベータトロン関数とディスパージョン関数を、図6に改善前と改善後のダイナミックアーチャを示す。

表3：1/2.5セル長ラティスの主なパラメータ

エネルギー (最大)	6 GeV
周長	396.12 m
チューン v_x / v_y	36.76/13.03
エミッタス	1.9 nm
クロマティシティ ξ_x / ξ_y	101.0/32.7
偏向電磁石 数	82
長さ	1.18 m
強さ	1.3 T

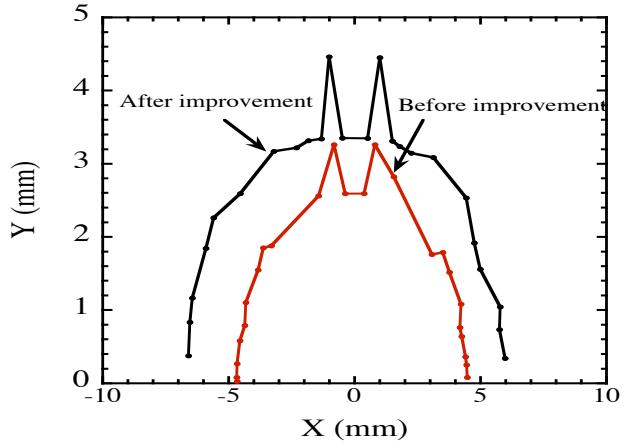


図6：1/2.5セル長のときのダイナミックアーチャ

3.5 縦方向の安定性

低エミッタスシンクロトロンはモーメンタムコンパクションファクター α が小さいので縦方向のアーチャーも確認しておく必要がある。そこで縦方向の位相空間を計算したものを図7に、計算に用いたパラメータを表4に示す。モーメンタムアクセプタンスは小さいが、シンクロトロンのエネルギー広がりはこの1/10なので問題ない。

表4：縦方向安定性計算時の主なパラメータ

項目	1/2セル長	1/2.5セル長
エネルギー損失(MeV/turn)	5.73	7.45
RF電圧(MV)	10	13
ハーモニック数	672	672
モーメンタムコンパクション α_0	5.74×10^{-4}	3.00×10^{-4}
α_1	1.56×10^{-3}	1.5×10^{-3}

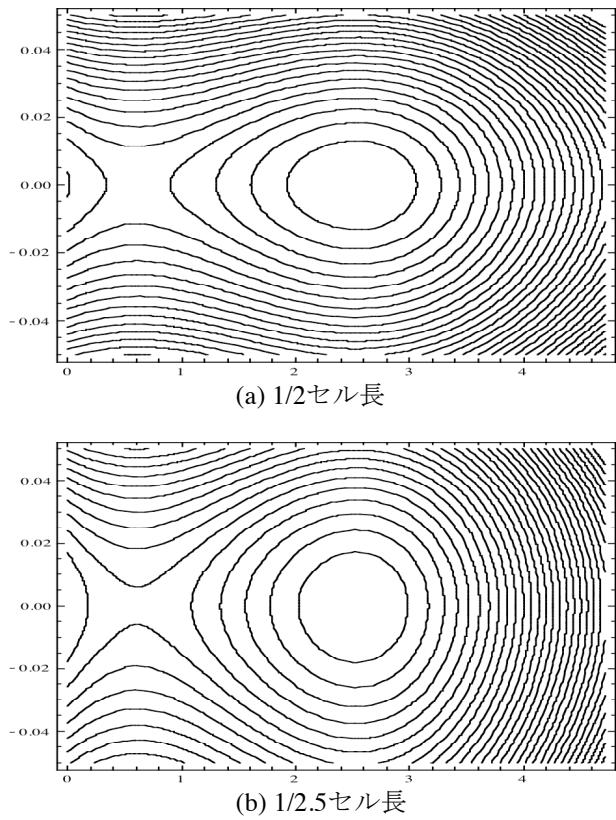


図7：1/2.5セル長のフェーズスペース

4. 比較

今までにラティス設計した低エミッタノンシンクロトロンのエミッタノン ϵ_0 とダイナミックアパー チャDAを表5に示す。FODOラティス^[2]に比べMEラティスが数倍から数十倍小さなエミッタノンを得ることができ、最小はもとのSPring-8シンクロトロンの1/120の1.9 nmまで小さくできることがわかる。これより低エミッタノンシンクロトロンは、FODOセルラティスよりMEラティスで構成した方が良いと思われる。

表5：低エミッタノンシンクロトロンの比較

種類	ϵ_0 (nm)	DA(mm)
1/1.6 cell length FODO ^[2]	30	+30/-28
1/2 cell length FODO ^[2]	25	+51/-36
1/3 cell length FODO ^[2]	11	+34/-30
1/2 cell length ME	3.7	+37/-54
1/2.5 cell length ME	1.9	+6.0/-6.6

5. まとめ

将来のダイナミックアパー チャの小さな超低エミッタノン蓄積リングの入射器として、シンクロトロンを低エミッタノン化することを検討し、SPring-8シンクロトロンに適用した。低エミッタノン化の方法として、ラティスをTMEに近づけたmulti-bend achromatラティスにすること、および、単位セルの長さを現在のSPring-8シンクロトロンより短くして偏向電磁石数をできるかぎり増やすこと、の二つの方法でアプローチした。

セル長を1/2にしたラティスではエミッタノンが3.7 nmになり、ダイナミックアパー チャは+37mm/-54mmと十分大きいことがわかった。セル長を1/2.5にしたラティスでは、エミッタノンは1.9 nmになるが、ダイナミックアパー チャは+6.0mm/-6.6mmと小さい。

以上より、ラティスをTMEに近づけたMBAにすること及び単位セル長を短くして偏向電磁石数を増やすことにより、もとのSPring-8シンクロトロンの1/120程度の数nmのエミッタノンを持つシンクロトロンが可能であることがわかった。

参考文献

- [1] M. Bei et al., Nucl. Instr. Met. A622, 518, (2010).
- [2] K. Tsumaki, Proc. Part. Accel. Society Meeting, Tokai, Japan, 2009, p. 3362.
- [3] JASRI-RIKEN SPring-8 Project Team, Conceptual Design Report, SPring-8 Project part I Facility Design 1991.
- [4] K. Tsumaki, N. Kumagai, Nucl. Instr. Met. A565, 394, (2006).